

7月5日（星期三）		成都祥宇宾馆三楼（凌云厅）
B1	13:20-13:50	金丝键成型模式及可靠性研究 肖 玲 研究员 中国电科芯片技术研究院
B2	13:50-14:20	微组装高精度自动贴片与引线键合工艺的研究 谢秀镗 高级工程师 众望赛米控（天津）科技有限公司
B3	14:20-14:50	大功率 GaN 芯片高效散热技术与发展趋势 季兴桥 研究员 中国电子科技集团第二十九研究所
	14:50-15:00	自助茶歇、参观展示、互动答题
B4	15:00-15:30	星载 MCM 模块集成制造技术 贾旭洲 微波毫米波微电路中心主任 航天五院西安分院空间电子产品制造中心
B5	15:30-16:00	共晶焊接界面特征及可靠性研究 陈杰 工艺总监 成都亚光电子股份有限公司
B5	16:00-16:30	通讯产品高速演进下的先进 SIP 封装需求分析 聂富刚 装联工艺技术总工 中兴通讯制造工程研究院
B7	16:30-17:00	倒装焊结构大规模集成电路焊点失效机理研究 胡 圣 总工程师研究员 中国航天时代第 771 研究所西安太乙电子有限公司